

薄板・平板・極細の微細プレス品がくつつかない 電解スズめっき

微細プレス品の機能性Snめっき技術(バレルめっき)

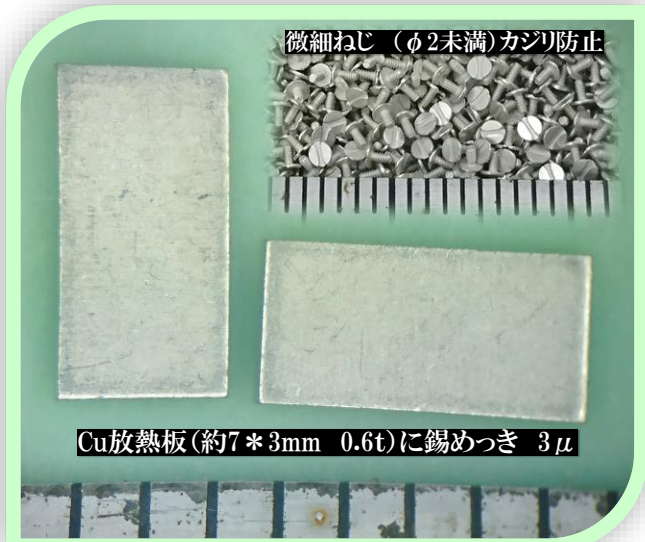
<技術概要>

半導体やあらゆる電子部品の放熱板やヒートシンク・リードピンは、放熱性のある銅や鉄材料をプレス・ヘッダー加工されたものが多く使われています。その際、主に防錆目的でニッケルめっき(Ni)、半田濡れ性の確保のために高価な銀めっき(Ag)等が活用されるケースがあります。



<問題点と解決>

反面、安価で防錆・濡れ性ともに確保できる錫めっきでは、製品同士がくつつきやすいため代替策として銀めっきやニッケルめっきを活用しているケースがあります。弊社では防錆・半田濡れ性のある機能性Snめっきを、くつつきによる歩留りを悪化させずにご提供できる工法の用途開発に取り組んでおります。試作承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



取り扱い材料

- ・銅系材料(銅・真鍮・その他 銅合金)
- ・鉄系材料(42アロイ・鉄 等)
- ・SUS系材料

加工種

プレス・切削・エッチング・ヘッダー加工等で製作された部品

完成品 納入できます

弊社で加工手配からめっきまで対応可

めっき仕様(電解めっき)

下地 : Cu/Ni
Ni-P(無電解ニッケル)
仕上げ: 光沢or半光沢Snめっき
めっき膜厚: 任意

~不可能への挑戦~

株式会社 友電舎

大阪市此花区常吉2丁目4番8号

TEL:06-6465-1663

Mail:joho1@ydn.co.jp

URL:http://www.ydn.co.jp

